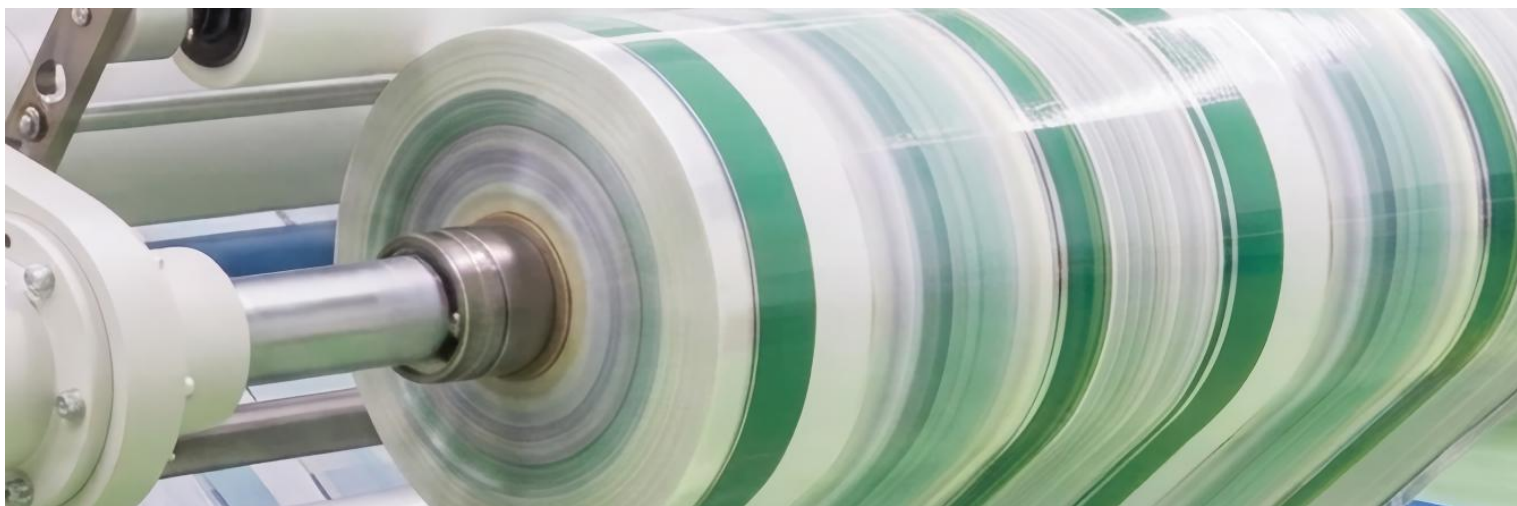
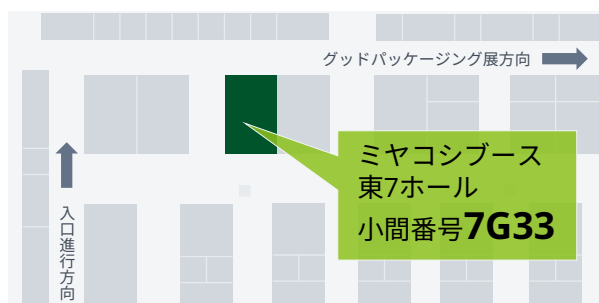




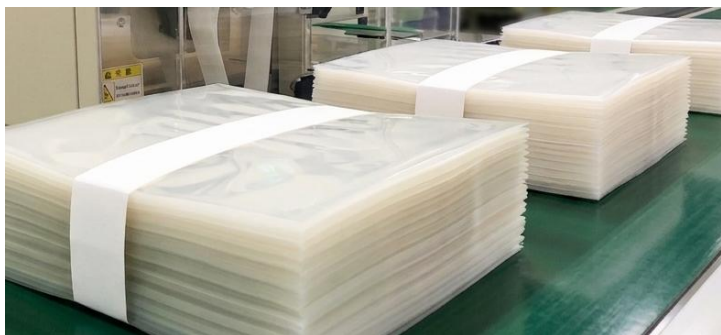
軟包装新天地

新しい時代を抜けて、いざ新天地へ。

2026/10/14_[wed] - **16**_[fri] 10:00-17:00



出展の見どころ



MSB22B実機デモ

製袋後工程の自動化による作業負荷の軽減

会場では、製袋機用インライン自動集積・結束装置MSB22Bの実機を展示し、製袋機から排出される袋を集積・帯掛けするまでの一連の動きをご覧いただけます。



AI印刷オペレーション支援 システムyalessシリーズ

yalessシリーズによる、印刷品質の安定化や損紙削減、技能継承を支える仕組みをパネルで紹介します。

軟包装製造の出荷前工程における作業負荷軽減

ロボットによる現場に合わせた自動化設計

袋取りや帯掛け、製函、箱詰め、梱包、包装ロールの積み降ろしなど、軟包装製品の出荷前工程における作業負荷軽減を提案します。



その他展示

MHL/MLP-EBシリーズ
MJP ADVANCEDシリーズ
MCI-Wシリーズ



FAST. SMART. CLEAN.

印刷工程における生産性向上と環境負荷低減

水性インクで毎分80mの高速印刷を実現するMJP ADVANCEDシリーズと、小中ロット生産に対応するEB硬化型オフセット印刷機MHL-EB/MLP-EBシリーズをご紹介します。また、環境性能と高い生産性を両立するCI型水性フレキソ印刷機MCI-Wシリーズについてもご紹介します。



入場には来場事前登録（無料）が必要です。
下記URLまたは、QRコードから事前登録
いただけます。

<https://www.tokyo-pack.jp/event/13994/users/register>

